

985M 液态助焊剂

低固态免洗助焊剂

产品概述

Kester 985M 是一款为波峰焊,选择性焊接以及手工焊接工艺而研发的,无卤化物,免清洗助焊剂.同时985M助焊剂也适用于传统的锡铅合金制程及无铅制程.在焊接过程中,985M展现了优良的降低桥接(短路)能力.这款助焊剂适用于汽车电子,电脑,通讯以及其它注重可靠性的领域.依据J-STD-004标准,Kester 985M被定义为ROLO型助焊剂.

优点特征

- 优良的焊接性能
- 不需要清洗,减少清洗费用
- 无腐蚀性,不发粘的残留物
- 依据J-STD-004标准,定义为ROLO型助焊剂
- 符合Bellcore GR-78 要求

RoHS 认证

Kester对于用户端使用有铅产品不决定其是否适用于任何RoHS豁免要求.

物理特性

比重: 0.805 ± 0.005
Anton Paar DMA 35 @ 25°C

固态含量(理论值): 3.6%
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.34

酸值(理论值): 20.0 mg KOH/g of flux
电位滴定测试法检测

可靠性

铜镜腐蚀: 低
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.32

铬酸银实验: 通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.33

氟化物点滴测试: 通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35.1

铜腐蚀测试: 低
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.15

氯,溴检测: 未检测到
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35

表面绝缘阻抗 (SIR) 检测: 通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.3.3
测试条件: 85°C, 85% RH, 7 days, 100V

Bono 腐蚀测试: 通过 Fc=0.7%
测试条件: 85°C, 85% RH, 15 days, 12V

	Blank	985M
第一天	1.3*10 ¹⁰ Ω	7.3*10 ⁹ Ω
第四天	9.7*10 ⁹ Ω	1.1*10 ¹⁰ Ω
第七天	8.2*10 ⁹ Ω	1.1*10 ¹⁰ Ω

✓ 产品应用

985M是专门为喷涂系统以及波峰焊接系统而设计,不适用于发泡形式的应用.助焊剂涂覆量应为90-190 g 固态物质/cm² (600-1200 g 固态物质/in²).

🔄 制程注意事项

对于大多数电路板组装而言,最适宜的预热温度为85-105°C (185-221°F),此为上板面或元件表面测量的温度,需要注意的最佳的预热温度设定需要结合设备的设计,板的质量以及尺寸,元器件的种类以及焊接使用的金属合金而定.关键是板的预热温度到达助焊剂的活性激活点而不是考虑在到达焊温度前将其燃烧殆尽.

有铅(Sn63Pb37)要求焊点与波峰接触时间为2-4秒,无铅(Sn96.5Ag3.0Cu0.5)焊接要求焊点与波峰接触时间为4-8秒,传输带的速度需要调整到在预热区有足够的接触时间让板达到设定的预热温度.如果有任何问题请联系Kester技术支持团队.

✓ 手工焊接应用

助焊笔只作为非常规使用,任何的助焊剂在被应用于此类焊接时都要保证焊接位置有被完全焊接到.

! 助焊剂控制

Kester PS-20 测试剂 # 53-0000-0200 可以用来检测助焊剂的固态含量,测试剂的使用手册随测试剂一同提供.它可以用来作为进货质量检测.或助焊剂容器在打开状态闲置后检测.溶剂质量会伴随时间而挥发有所影响.稀释剂建议使用Kester的4662.

💧 清洗

Kester 985M的残留物是不导电,无腐蚀性的,在大多数应用的情况下无需清洗.若需要清洗,请致电咨询Kester技术支持.

📦 存储和保存期限

Kester 985M 是易燃性的,请远离火源存储.在10-25°C (50-77°F)条件下其保质期限为从生产日期起为期1年.

⚠️ 健康与安全

本产品在搬运或使用过程中,可能会对健康或环境造成危害.在使用本产品前,请认真阅读材料安全说明书和警示标签.